

吉達電子有限公司

雙液型環氧樹脂 J100-A/J100-B

A. 用途與特性:

1. 可常溫硬化，低黏度，操作容易。
2. 符合 UL94V-0 耐燃規格。
3. 電性佳、絕緣性良好，適用於電子零件絕緣封膠。

B. 硬化前特性:

	J100-A	J100-B
成分	環氧樹脂	芳香族氨
外觀	黑色液狀	棕色液狀
黏度 CPS (25°C)	35000 cps	2000 cps
比重 (25°C)	1.87	1.10

C. 操作條件:

- 混合比: A : B = 100 : 15 (重量配合比)
混合黏度: 8000 ~ 10000 cps (25°C)
可用時間: 6 hrs (100g/25°C)
硬化條件: 4 hrs @100°C or 2 hrs @120°C.

D. 硬化物特性:

硬度 (SHORE D)	88
抗彎強度 (kg/cm ²)	850
玻璃轉移溫度 (Tg)	135°C
膨脹係數 (cm/cm/°C)	4.5×10^{-5}
體積阻抗 (ohm-cm 25°C)	1.2×10^{15}
誘電率 (1KHz 25°C)	4.6

吉達電子有限公司

